

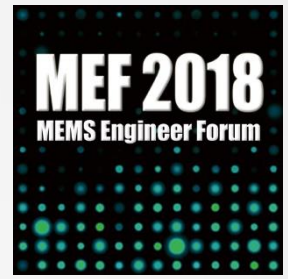
MEMS Engineer Forum 2018

SMART Society Driven by MEMS

April 25-26, 2018

KFC Hall, Ryogoku, Tokyo, Japan

カンファレンス聴講料・技術展来場無料（懇親会有料）



技術展示出展のご案内

<http://www.m-e-f.info/>

本フォーラムは、21世紀のキーテクノロジーとされるMEMS技術の現状と、向こう10年までの技術の将来に迫る、この分野のキープレイヤーの中でもエンジニアを中心に運営されるユニークな場です。世界中のMEMS研究者、開発者、技術者が一堂に集うこのフォーラムは、2009年3月の初開催以降、回を重ね、MEF2018で第10回を迎えることとなります。

MEMSに関する基礎技術ならびに隣接分野の技術において、エンジニアならではの視点と技量で、新しいカタチを形成し、そして融合させて参ります。さらに融合の過程や完成に向かう姿を国際的なレベルで検証することをミッションとしております。展示会(4/25-26の2日間、40-50小間)を開催致します。是非ご出展頂けますようお願い致します。



MEF2018の講師陣

Keynote Speakers

Prof. Frank Niklaus, KTH Royal Institute of Technology in Stockholm (Sweden)

Dr. Thomas Kenny, Stanford University (USA)

Kurt Petersen, Silicon Valley Band of Angels (USA)

Dr. Albert P. Pisano, UC San Diego (USA)

江刺 正喜, 東北大学 (Japan)

神永 晋, SPPテクノロジーズ (Japan)

川合 知二, 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) (Japan)

Guest Speakers

Dr. Evangelos A. Angelopoulos, Infineon Technologies (Germany)

Dr. Sitram Arkalgud, Xperi (USA)

"Emerson CW Cheng, TSMC (Taiwan)"

Jean-Christophe ELOY, YOLE Developpment (France)

Dr. Christiane Kaden, Fraunhofer IPMS (Germany)

Jerry Liu, SMIC (China)

Jean-Philippe Polizzi, CEA-Leti (France)

Magnus Rimskog, Silex Microsystems(Sweden)/

加藤 健二, 協同インターナショナル (Japan)

Frank A. Shemansky, Jr., PhD, SEMI Global Headquarters (USA)

Dr. Jan Peter Stadler, Robert Bosch, Automotive Electronics (Germany)

Peter Zalar, HOLST Centre (The Netherlands)

衛藤 大亮, 富士フイルム和光純薬 (Japan)

荻浦 美嗣, ムラタエレクトロニクスフィンランド (Japan)

桑野 博喜, 東北大学/仙台スマートマシーナズ (Japan)

瀧本 貞治, 浜松ホトニクス (Japan)

中川 敦寛, 東北大学 (Japan)

谷津田 博美, 日本無線 (Japan)

出展者特典	一般企業	アカデミック	ベンチャー企業
	¥250,000	¥50,000	¥50,000
1 ショートプレゼンテーション枠の使用権	○	×	○
2 MEF2018予稿集への広告掲載	1頁○	1頁○	1頁○
3 MEF2018ウェブサイトにのバナー掲載	○	○	○
4 MEF2018セッション・展示会場内にロゴ掲載	○	○	○
5 PRビデオのループ上映	○	○	○
6 懇親パーティへの招待(4/25)	1名様*	×	×
7 MEF2018招待講演者昼食席招待(4/25、26)	2名様*	×	×
8 VIPルーム使用权	○	○	○

企業PRの支援

招待・優待

上記金額は税別です

*1月31日までにお申込の場合、招待枠が2倍となります

MEF2018実行委員会幹事

委員長 桑野 博喜 東北大学 大学院

副委員長 江刺 正喜 東北大学

副委員長 神永 晋 SPPテクノロジーズ

副委員長 小林 直人 早稲田大学

プロジェクトリーダー

石田 博之 ズース・マイクロテック

田中 秀治 東北大学大学院

野副 真理 日立ハイテクノロジーズ

宮島 博志 オリジナルパス

一般企業展示

サイズ W1800mm×D900mm×H1800mm

(展示台高さ:700mm)

基礎小間には以下を基本パッケージとします。

・バックパネル

・社名板(スミ 1 色、統一書体)

・展示台(テーブルクロス、スカート布で覆われます)

・コンセント 500W(2 口付き)

・椅子 1 脚

アカデミック展示・ベンチャー企業展示

アカデミック展示小間仕様

基礎小間サイズ幕板付長机

(W1800mm×D450mm×H700mm)+バックパネル

(H1800mm)

*バックパネルはポスター掲示が可能です。